

BUSINESS MODEL INNOVATION – NEUE EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR MIKROVERKAPSELUNG

Donnerstag, 28. Oktober 2010

ZIELE UND INHALTE

Die Mikroverkapselung bietet unterschiedlichen Branchen vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Von den Life-Science-Bereichen Pharma, Medizin, Kosmetik oder der Lebensmitteltechnologie bis hin zur Bau-, Papier-, Elektronik-, Textil- und Chemieindustrie kommen Mikro-kapseln in den unterschiedlichsten Produkten zum Einsatz. Das Potenzial dieser Technologie ist dabei noch längst nicht ausgeschöpft: Obwohl die Technologie selbst schon einige Jahrzehnte alt ist, werden immer wieder neue Anwendungsfelder durch technische Inventionen erschlossen.

Das Fraunhofer IAP und Fraunhofer IAO laden Sie nun herzlich ein, sich im Rahmen des Forums »Business Model Innovation – neue Einsatzmöglichkeiten für Mikroverkapselung« über neue Entwicklungen im Bereich der Mikroverkapselung zu informieren.



Es erwartet Sie ein Programm mit informativen Vorträgen zu den verschiedenen Facetten des Themas Mikroverkapselung: Von Mikrokapseln für den Gebäudeschutz, für Textilanwendungen und selbstheilende Materialien bis hin zu Fördermöglichkeiten in relevanten Bereichen der Werkstoff- und Verfahrenstechnik. Darüber hinaus stehen Ihnen Experten aus Industrie und Forschung für Diskussionen im Rahmen einer Fachausstellung zur Verfügung.

Sowohl Unternehmen, die bereits im Bereich Mikroverkapselung tätig sind, als auch Unternehmen, die in diesem Bereich erst Fuß fassen möchten, bietet sich hier die Gelegenheit, mehr über Potenziale und neue Einsatzmöglichkeiten der Mikroverkapselung zu erfahren.

TERMIN | 28. Oktober 2010

TAGUNGSORT | Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP, Geiselbergstraße 69, 14476 Potsdam-Golm, großer Seminarraum

VERANSTALTER | Verein zur Förderung produktionstechnischer Forschung e.V. (FpF), Stuttgart, Fraunhofer IAP, Potsdam und Fraunhofer IAO, Stuttgart

VERANSTALTUNGSORGANISATION |

Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP, Geiselbergstraße 69, 14476 Potsdam-Golm

Dipl.-Inform. (FH) Nadine Gruber

Telefon +49 331 568-1251

Fax +49 331 568-3000

info@iap.fraunhofer.de

FACHANSPRECHPARTNER |

Dipl.-Ing. Monika Jobmann

Telefon +49 331 568-1213

monika.jobmann@iap.fraunhofer.de

PROGRAMM

28. OKTOBER 2010

- 9.00 Uhr** **Begrüßung**
- 9.30 Uhr** **Geschäftsmodellinnovationen – Die Wichtigkeit der Kundenzentrierung bei neuen Geschäftsmodellen**
Dr. oec. Patrick Stähler – Fluidminds GmbH, Zürich
- 10.00 Uhr** **Neue industrielle Entwicklungen im Bereich der Nano - und Mikroverkapselung**
Dr. Klaus Last – Follmann, Minden
- 10.30 Uhr** **Kaffeepause**
- 11.00 Uhr** **Nanocontainer-based self-healing coatings**
Dr. Dmitry Schukin – Max-Planck-Gesellschaft, Potsdam
- 11.30 Uhr** **SOLARDIM-ECO - Mikrokapseln für den Gebäudesonnenschutz**
Dr. W. Werner – Tilse Formglas GmbH, Liepe
Dr. O. Mühling – Fraunhofer IAP, Potsdam
- 12.00 Uhr** **Fats in Microencapsulation Applications – Benefits & Challenges**
Dr. Jamileh M. Lakkis – Lipofood, Barcelona
- 12.30 Uhr** **Mittagspause**
- 13.30 Uhr** **Microencapsulation in Textiles »Present Position and Future Opportunities«**
Dr. Gordon Nelson – Burgundy Gold LTD, Kingsley
- 14.00 Uhr** **Solvent substitution in a microencapsulation process using Hansen solubility parameters**
Prof. Dr. Bordes, Prof. Dr. Lanteri - University of Lyon, Lyon
- 14.30 Uhr** **Nano encapsulated siRNA in active coatings for medical implants, problems and perspectives**
Dr. Simona Margutti – Fraunhofer IAO, Stuttgart
Priv.-Doz. Dr. Rumen Krastev -Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut, Reutlingen
- 15.30 Uhr** **Kaffeepause**
- 16.00 Uhr** **Bioresorbierbare Mikropartikel für die generative Fertigung**
Monika Jobmann - Fraunhofer IAP, Potsdam
Simon Höges – Fraunhofer ILT, Aachen
- 16.30 Uhr** **Fördermöglichkeiten in der Werkstoff- und Verfahrenstechnik**
Rudolf Spitzmüller – Spitzmüller AG, Gengenbach
- 17.00 Uhr** **Fraunhofer IAP – Lab Tour**

ALLGEMEINE HINWEISE

ANMELDUNG | Die Anmeldung erfolgt anhand der beiliegenden Karte oder per E-Mail unter folgender Adresse: nadine.gruber@iap.fraunhofer.de. Eine Anfahrtsskizze, weitere organisatorische Details sowie die Rechnungsstellung erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung. Eine elektronische Anfahrtsskizze erhalten Sie auch im Internet unter <http://www.iap.fraunhofer.de/institut/anfahrt.html>.

FRÜHBUCHERRABATT | Bei einer Anmeldung bis zum 28. September wird ein Frühbucherrabatt von 100 € gewährt.

TEILNAHMEGEBÜHR | Die Teilnahmegebühr für die Veranstaltung beträgt 295 € pro Person. In der Gebühr enthalten sind die Teilnahme an den Vorträgen, Tagungsunterlagen, das Mittagessen sowie die Erfrischungen während der Pausen.

ANMELDESCHLUSS | 22. Oktober 2010

UMSCHREIBUNG DER ANMELDUNG | Die Umschreibung der Anmeldung auf einen anderen Teilnehmer ist jederzeit kostenlos möglich.

ABMELDUNG | Bei Abmeldungen bis zum 29. September 2010 werden 75 € berechnet. Bei späteren Abmeldungen wird die volle Teilnahmegebühr berechnet.

ZIMMERVERMITTLUNG | Sollten Sie für Ihren Aufenthalt in Potsdam ein Hotelzimmer benötigen, wenden Sie sich mit dem Stichwort »Mikroverkapselung« bis zum 28.8.2010 an:

Landhotel Potsdam
Reiherbergstraße 33
14476 Golm
Telefon +49 331 601190
Fax +49 331 60119500
info@landhotel-potsdam.de

oder wenden Sie sich an:

Potsdam Tourismus Service
Am Neuen Markt 1
14467 Potsdam
Telefon +49 331 275580
Fax +49 331 2755829
tourismus-service@potsdam.de
www.potsdamtourismus.de

RECHNUNGSADRESSE

Name, Vorname _____

Firma _____

Postfach, Straße _____

Postleitzahl, Ort _____

Fraunhofer-Institut
für Angewandte Polymerforschung IAP
PR & Marketing
Geiselbergstraße 69
14476 Potsdam-Grube

ANMELDUNG PER POST ODER FAX +49 331 568-3000

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Forum »Business Model Innovation – neue Einsatzmöglichkeiten für Mikroverkapselung« am 28. Oktober 2010 in Potsdam-Golm an.

HINWEIS | Gemäß des Bundesdatenschutzgesetzes unterrichten wir Sie über die Speicherung Ihrer Anschrift in einer Datei und die Bearbeitung mit automatischen Verfahren. Die im Programm bekannt gegebenen Bedingungen der Anmeldung und Abmeldung habe ich zur Kenntnis genommen.

Name, Vorname _____

Titel _____

Firma _____

Abteilung _____

Postfach, Straße _____

Postleitzahl, Ort _____

Telefon, Fax _____

E-Mail _____

Ort, Datum _____

Unterschrift _____